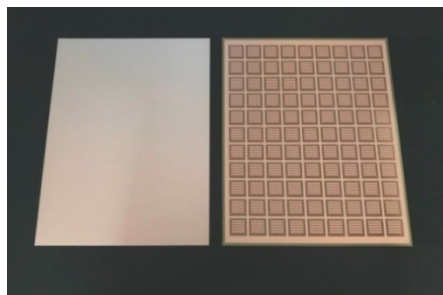
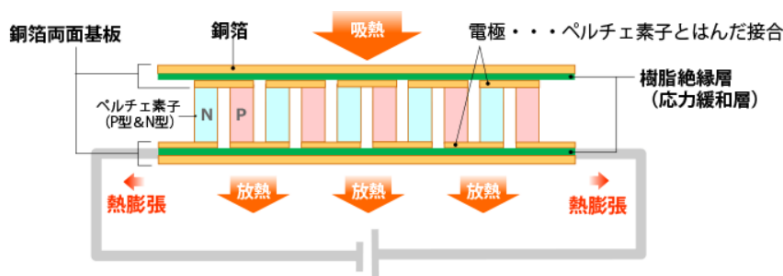


特長

ペルチェモジュールなどの熱電モジュールに最適な両面銅箔付きの高熱伝導・低弾性樹脂基板です



外観



用途例・ペルチェ素子サーモ・モジュールへの適用

- ・低弾性の樹脂絶縁層が基板の電極と熱電素子の接合部に発生する熱応力を緩和することにより熱電モジュールの長寿命化に貢献します。
- ・熱伝導性(低熱抵抗)、電気絶縁性、耐熱性、接着強度(銅箔引き剥がし強度)に優れます。
- ・基板の両面に銅箔を採用しているため、熱電モジュールの熱応答性、放熱性を向上させます。
- ・基板に厚銅箔を採用しているため、熱電モジュール以外の大電流用基板としても使用できます。

一般仕様

項目	仕様
銅箔厚	70 μm , 105 μm
絶縁層厚	70~100 μm
絶縁層 熱伝導率	1.5 W/mK < , 4.0 W/mK <
絶縁層 ガラス転移温度	50°C >
絶縁層 貯蔵弾性率 (100°C)	0.5 GPa >
銅箔引き剥がし強度	1.5kN/m <
長期耐熱性(銅箔引き剥がし強度)	150°C/3000h
はんだ耐熱性 (280°C)	300sec <
耐電圧	2kV <

※銅箔厚、絶縁層熱伝導率は選択可能です。 絶縁層厚は仕様範囲で調整可能です